



Bosch investiert 2022 mehr als 400 Millionen in seine Halbleiterstandorte Dresden, Reutlingen und Penang werden ausgebaut

29. Oktober 2021

PI 11404 BBM Fi/af

- ▶ Bosch reagiert auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern.
- ▶ 300-Millimeter-Halbleiterwerk in Dresden soll schneller ausgebaut werden.
- ▶ In Reutlingen entstehen 4 000 Quadratmeter neue Reinraumfläche bis Ende 2023.
- ▶ Bosch schafft 150 Stellen in der Halbleiterentwicklung in Reutlingen.
- ▶ Neues Halbleiter-Testzentrum in Penang, Malaysia, wird gebaut.

Stuttgart – Bosch investiert weiter gegen die weltweite Halbleiter-Krise. Nur wenige Wochen nach der Eröffnung seiner neuen Waferfab in Dresden kündigt das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen jetzt eine zusätzliche Investition im dreistelligen Millionenumfang in seine Chipfertigungen an. Allein im Jahr 2022 plant Bosch, mehr als 400 Millionen Euro in den Ausbau seiner Halbleiterstandorte in Dresden, Reutlingen und im malaysischen Penang zu investieren. „Der Bedarf an Halbleitern wächst weiter rasant. Gerade in der aktuellen Lage bauen wir deshalb die Fertigung von Halbleitern konsequent aus, um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen“, sagt Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. Mit einem Großteil der Investitionen sollen im Jahr 2022 Fertigungsflächen im neuen 300-Millimeter-Halbleiterwerk von Bosch in Dresden noch schneller ausgebaut werden. Rund 50 Millionen Euro der geplanten Summe fließen im kommenden Jahr zudem in das Halbleiterwerk in Reutlingen bei Stuttgart. Dort investiert Bosch von 2021 bis 2023 insgesamt 150 Millionen Euro für zusätzliche Reinraumflächen. Von Grund auf neu baut Bosch ein Testzentrum für Halbleiter in Penang, Malaysia. Ab 2023 sollen dort fertige Halbleiter-Chips und Sensoren getestet werden. „Die geplanten Investitionen belegen einmal mehr die strategische Bedeutung unserer eigenen Fertigungskapazitäten in der Schlüsseltechnologie der Halbleiter“, sagt Denner.

Schnellerer Hochlauf in Dresden, neue Reinnräume in Reutlingen

„Unser Ziel ist es, die Produktion von Halbleitern in Dresden früher als geplant hochzufahren und gleichzeitig die Reinraumkapazität in Reutlingen zu erweitern.“

Jeder zusätzliche Chip aus unserer Produktion hilft in der aktuellen Situation“, sagt Harald Kröger, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH. Insgesamt wird in Reutlingen die Reinraumfläche von aktuell 35 000 Quadratmetern in zwei Schritten um mehr als 4 000 Quadratmeter vergrößert. Der erste Schritt – die Erweiterung der Fertigungsfläche für 200-Millimeter-Wafer um 1 000 Quadratmeter auf insgesamt 11 500 Quadratmeter – ist bereits abgeschlossen. In den vergangenen Monaten wurden dafür Büroflächen in einen Reinraum umgewandelt und über eine Brücke mit der bestehenden Waferfab verbunden. Die Produktion von Halbleitern auf der neuen Fläche läuft seit September. „Bereits jetzt haben wir die Fertigungskapazität für 200-Millimeter-Wafer um rund zehn Prozent erhöht“, sagt Kröger. Die Investition hierfür betrug 50 Millionen Euro (in 2021). Damit reagiert das Unternehmen insbesondere auf die gestiegene Nachfrage nach MEMS-Sensoren und Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern. In einem zweiten Schritt werden bis Ende 2023 weitere 3 000 Quadratmeter Reinraumfläche geschaffen. Dafür investiert Bosch weitere je rund 50 Millionen Euro in den Jahren 2022 und 2023. Am Standort Reutlingen schafft Bosch zudem 150 neue Stellen in der Halbleiterentwicklung.

Neues Testzentrum in Penang, Malaysia

Ein weiterer Teil der für 2022 geplanten Investitionen fließt in ein neues Halbleiter-Testzentrum in Penang, Malaysia. In der hochautomatisierten und vernetzten Fabrik soll ab 2023 das Testen von Halbleiterchips und Sensoren stattfinden. Insgesamt stehen Bosch auf dem Festlandstreifen Penangs über 100 000 Quadratmeter Grundstücksfläche zur Verfügung, die schrittweise ausgebaut werden sollen. Zunächst entsteht das Testzentrum mit einer Fläche von rund 14 000 Quadratmetern – darin Reinräume, Bereiche für Büros, Forschung und Entwicklung sowie Schulungsmaßnahmen für die bis zu 400 Mitarbeiter. Die Erdarbeiten für den neuen Standort wurden bereits Ende 2020 begonnen. Die Gebäude entstehen seit Mai 2021. Das Testzentrum soll im Jahr 2023 seinen Betrieb aufnehmen. Die zusätzlichen Testkapazitäten in Penang sollen künftig Freiräume schaffen, um in den Halbleiterfabriken von Bosch neue Technologien ansiedeln zu können, wie Siliziumkarbid-Halbleiter in Reutlingen. Zudem können durch den neuen Standort in Asien Lieferzeiten und -wege für Chips deutlich verkürzt werden.

Alleinstellungsmerkmal Halbleiter

Mikroelektronik ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für alle Geschäftsfelder von Bosch. Das Unternehmen hat das Potenzial der Technik bereits früh erkannt und produziert Halbleiter seit mehr als 60 Jahren. Bosch ist damit eines der wenigen Unternehmen, das neben Know-how in den Bereichen Elektronik und Software auch über ein tiefes Verständnis der Mikroelektronik verfügt. Diesen entscheidenden Wettbewerbsvorteil kombiniert Bosch mit seiner Stärke in der

Fertigung von Halbleitern. In Reutlingen produziert das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen bereits seit 1970. Sie kommen sowohl im Automobilbereich als auch in der Konsumentenelektronik zum Einsatz. Moderne Elektronik im Auto ist Basis für Klima- und Unfallschutz im Straßenverkehr sowie Effizienz im Antrieb. „Bosch verbindet seine spezifische Halbleiter- und Automobilkompetenz, um überlegene elektronische Systeme zu entwickeln. Davon profitieren unsere Kunden und unzählige Menschen, die auch künftig sicher und effizient mobil sein wollen“, sagt Kröger. Die Produktion in Boschs 300-Millimeter-Fabrik in Dresden startete im Juli dieses Jahres – ein halbes Jahr früher als geplant. Die im neuen Werk hergestellten Halbleiter kommen zunächst in Elektrowerkzeugen von Bosch zum Einsatz. Für den Bedarf der Automobilindustrie begann die Chip-Produktion im September und damit ein Vierteljahr früher als geplant. Für seine Halbleiterfertigungen in Reutlingen und Dresden hat Bosch seit der Einführung der 200-Millimeter-Technologie im Jahr 2010 mehr als 2,5 Milliarden Euro investiert. Hinzu kommen weitere Investitionen in Milliardenhöhe für die Entwicklung der Mikroelektronik.

Weitere Informationen:

[Factsheet zur Halbleiterfertigung bei Bosch](#)

[Factsheet zur Halbleiterfertigung von Bosch in Reutlingen](#)

Pressebilder: 52ab997c, e52fc3e0, a092ebf2, ee633fca, 6b8bb829

Journalistenkontakt:

Annett Fischer,

Telefon: +49 711 811-6286

Twitter: @Annett__Fischer

Mobility Solutions ist der größte Unternehmensbereich der Bosch-Gruppe. Er trug 2020 mit 42,1 Milliarden Euro 59 Prozent zum operativen Umsatz bei. Damit ist das Technologieunternehmen einer der führenden Zulieferer der Automobilindustrie. Der Bereich Mobility Solutions verfolgt die Vision einer sicheren, nachhaltigen und begeisternden Mobilität der Zukunft und bündelt seine Kompetenzen in den Domänen – Personalisierung, Automatisierung, Elektrifizierung und Vernetzung. Seinen Kunden bietet der Bereich ganzheitliche Mobilitätslösungen. Die wesentlichen Geschäftsfelder sind: Einspritztechnik und Nebenaggregate für Verbrennungsmotoren sowie vielfältige Lösungen zur Elektrifizierung des Antriebs, Fahrzeug-Sicherheitssysteme, Assistenz- und Automatisierungsfunktionen, Technik für bedienerfreundliches Infotainment und fahrzeugübergreifende Kommunikation, Werkstattkonzepte sowie Technik und Service für den Kraftfahrzeughandel. Wichtige Innovationen im Automobil wie das elektronische Motormanagement, der Schleuderschutz ESP oder die Common-Rail-Dieselsystemtechnik kommen von Bosch.

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 395 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2020). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 71,5 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Industrie 4.0 und Connected Mobility. Bosch verfolgt die Vision einer nachhaltigen, sicheren und begeisternden Mobilität. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT-Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen und Produkte für das vernetzte Leben, die entweder über künstliche Intelligenz (KI) verfügen oder mit ihrer Hilfe entwickelt oder hergestellt werden. Mit innovativen und begeisternden Produkten sowie Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH sowie ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Mit ihren weltweit mehr als 400 Standorten ist die Bosch-Gruppe seit Frühjahr 2020 CO₂-neutral. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 73 000 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 129 Standorten, davon etwa 34 000 Software-Entwickler.

Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse.